

梅州市 2025 年度铜箔—高端印制电路板领域应用基础研究项目

序号	专题	项目名称	承担单位	资金来源
1	梅州市 2025 年度铜箔—高端印制电路板领域应用基础研究项目	动力电池用耐高温衰减特高强度电解铜箔研发及产业化	广东嘉元科技股份有限公司	自筹